

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-114

广州天赐高新材料股份有限公司 关于增加 2021 年度向相关金融机构申请融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 23 日、2021 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议、2020 年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2021 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 38 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日、2021 年 4 月 16 日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2021 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司及子公司业务和项目建设的顺利开展，公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，拟增加向相关金融机构申请融资额度 32 亿元，本事项尚需提交股东大会审议。结合公司 2020 年度股东大会审议批准的向相关金融机构申请融资额度 38 亿元，公司 2021 年度向相关金融机构申请融资额度增加至 70 亿元。

上述综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司或子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物，或由公司提供连带责任担保。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至 2021 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及公司子公司法定代表人签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年8月24日